

# LCP 日本新石油化学FC-110连接器专用LCP塑胶原料标准化服务

产品名称	LCP 日本新石油化学FC-110连接器专用LCP塑胶原料标准化服务
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

## 产品详情

一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下长期受力,会出现形变;

聚甲醛是一种无侧链高密度结晶性聚合物,具有优异的综合性能。

COC是新型的具有环状烯烃结构的非晶性透明共聚到分子材料,其具有作为光学部件非常重要的低双折射率以及低吸水性高刚性等优良性能。

塑胶原料大部分可循环使用,但由于翻用塑料(水口料)比一般原料要脆,所以只可混合新料(原料)一起使用,比例最大不可超过25%为合适,应以顾客要求标准为原则.各种类型的塑料料因所需的熔点不同,所受的注塑压力不同,生产中一定不可相混淆。

PBT塑胶材料常被用于生产2.54间距180度/90度的排母连接器产品之上,塑料端子壳的耐焊接温度只有200度左右,由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性,现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。

很不耐酸,不耐强碱和不耐紫外线的辐射。(加入UV剂,能大大提高其耐紫外线等级)

液晶聚合物分子的分之主链刚硬,分子之间堆砌紧密,且在成型过程中高度取向,所以具有线膨胀系数小,成型收缩率低和非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,具有较高的负荷变形温度,有些可高达340 以上。

聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,薄壁部分呈半透明。

改性聚醚醚酮有黑色碳纤增强导电聚醚醚酮、红色碳纤增强导电聚醚醚酮、有矿物增强聚醚醚酮、有玻纤增强聚醚醚酮及PEEK树脂。虽然聚醚醚酮具有许多优良性能,但是价格昂贵,限制了其在一些领域的应用。另外,它的冲击强度较差,为了进一步提高其性能,以满足各个领域的综合性能和多样化需要

，可采用填充、共混、交联、接枝等方法对其进行改性，以得到性能更加优异的PEEK塑料合金或PEEK复合材料。例如：PEEK与聚醚共混可得到更好的力学性能和阻燃性；PEEK与PTFE共混制成复合材料，具有突出的耐磨性，可用于制造滑动轴承、动密封环等零部件；PEEK用碳纤维等填充改性，制成增强的PEEK复合材料，可大大提高材料的硬度、刚性及尺寸的稳定性等。

工程塑料通用塑料的价格虽低廉，但是它的力学性能，耐温、耐腐蚀性能均难以满足某些工程和设备中用作结构材料的需要，为此工程塑料应运而生，它机械强度高，刚性大，能取代某些钢铁或有色金属材料，可制造结构复杂的机械零件或工程受力件，很多使用效果还超过原来的材料，常用的工程塑料有PA、ABS、PSF、PTFE塑胶原料、POM塑胶原料、PC等。

有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;

它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。

一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;

塑胶原料：是由高分子合成树脂(聚合物)为主要成份渗入各种辅助料或某些具有特定用途的添加剂，在特定温度，压力下具有可塑性和流动性，可被模塑成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚矾等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。